

27th International Conference on Electronic Packaging Technology

第27届电子封装技术国际会议

2026年8月5-7日，中国·西安



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第 27 届电子封装技术国际会议（ICEPT 2026）

2026 年 8 月 5-7 日，中国·西安

会议通知

第 27 届电子封装技术国际会议(ICEPT 2026)将于 2026 年 8 月 5 日至 7 日在中国西安举行。会议由中国科学院微电子研究所、西安交通大学、国际电气电子工程师协会电子封装学会(IEEE-EPS)和中国电子学会电子制造与封装技术分会(CIE-EMPT)主办，由西安交通大学微电子学院、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、陕西省半导体行业协会和北京恒仁致信咨询有限公司承办。ICEPT 会议是国际最著名的电子封装技术会议之一，会议得到了 IEEE-EPS 的大力支持和中国电子学会、中国科协的高度评价，已成为国际电子封装领域四大品牌会议之一。后摩尔时代背景下，半导体制造技术面临挑战，新技术不断涌现，先进封装在产业链中的地位愈加重要。本会议将为来自海内外学术界和工业界的专家、学者和研究人员提供电子封装与制造技术新进展、新思路的学术交流平台。

在为期三天的会议中，来自多个国家和地区的参会者将通过主题报告、专题讲座、特邀报告、论文张贴(Poster)、展览展示、分会报告等形式，交流电子封装技术的最新技术发展。我们诚挚地邀请您参加此次会议!

一、大会主要信息

专业发展课程培训:	大会:
1.听课注册: 2026 年 8 月 4 日	1.现场注册: 2026 年 8 月 5 日
2.讲座日期: 2026 年 8 月 5 日上午	2.会议时间: 2026 年 8 月 5 日下午、8 月 6-7 日全天

会议地点：中国·西安 西安豪享来温德姆至尊酒店（陕西省西安市曲江新区慈恩东路 208 号）

会议官方网站：www.icept.org Email: icept@fsemi.tech

投稿链接：<https://easychair.org/conferences?conf=icept2026>

摘要及论文提交：

2026 年 3 月 20 日，摘要投稿截止日期；2026 年 4 月 20 日，摘要接收通知日期

2026 年 5 月 20 日，全文投稿截止日期；2026 年 6 月 30 日，全文接收通知日期

会议规模：800-1000 人



二、会议专题

- **先进封装：**2.5/3D 封装，芯粒（Chiplet）集成，晶圆级/板级扇出与扇入型封装，倒装芯片封装，系统级集成，先进封装热管理，其他异质异构集成封装技术。
- **封装材料与工艺：**封装材料，绿色/纳米封装材料，高端封装基板技术，自对准和组装技术，其他与封装相关的半导体材料与工艺。
- **封装设计与建模：**复杂封装的设计、建模、算法与仿真技术，跨尺度与多物理场的特性建模、算法与仿真技术，工艺仿真技术等。
- **互连技术：**硅通孔（TSV）、玻璃通孔（TGV），凸点和微铜柱技术，高密度互连技术，混合键合技术，纳米材料键合技术，芯片-晶圆/面板和晶圆-晶圆互连技术，热压焊技术，其他新型互连技术等。
- **先进制造：**先进封装工艺牵引下的制造、组装、测试等封测设备，新原理封测设备，设备主要或关键零部件、模组技术。
- **质量与可靠性：**封装测试技术，新型可靠性实验技术，可靠性评估方法，可靠性数据采集和分析方法，可靠性仿真，寿命预测，失效分析和无损检测。
- **功率电子与能源电子：**功率电子封装相关互连、热管理和基板技术，宽禁带半导体封装技术，超宽禁带半导体封装技术，IGBT、SiC、GaN 混合封装技术，高电压封装技术，高结温封装技术，多功能集成封装技术，其他功率半导体封装技术，开关、隔离/非隔离电源、逆变器、IPM、POL、PSiP 等功率模组的封装与集成方法，功率模组控制算法，EMI 建模与优化，工业模组和车规模组及系统，其他新能源及新型功率电子模组。
- **光电子与显示技术：**光显示、光通信、光传感、激光器，新型显示等封装内光电集成的设计、仿真、互连、封装、可靠性及失效分析等技术。
- **射频电子封装：**射频集成电路与封装交互设计、射频封装与模组设计、射频异质集成工艺、

射频无源器件与集成、射频器件与系统散热、射频封装可靠性、毫米波/THz 前沿技术、封装天线一体化、封装射频噪声抑制、声表/体声波谐振器、滤波器相关技术等。

- **新兴领域封装：**适用大算力芯片的带宽提升与规模提升的封装技术，大算力芯片的集成电源技术，大算力芯片的高效散热技术，脑机接口，垂直供电技术，新兴器件封装，新型二维材料器件封装，量子技术，微/纳机电系统（MEMS/NEMS）封装，传感器封装，植入式器件封装，微流体 3D 打印封装，微机电和传感器的晶圆级/板级封装，可穿戴/柔性和生物电子封装等。
- **AI 赋能的先进封装：**AI/ML 驱动的设计、代理建模与协同优化，ML/DL 在质量控制、工艺优化、可靠性预测与失效分析中的应用，生成式 AI，数字孪生，AI 辅助的芯片-封装-系统协同设计与集成。面向高性能 AI 的先进封装架构与技术（异质集成、2.5D/3D、芯粒技术），面向 AI 系统的电源传输、信号完整性与热管理；系统级解决方案。

三、展位征集

ICEPT 2026 期间将会同时举办电子封装技术国际展，为封装测试技术产品、科研仪器与设备、材料、组件、软件供应商、制造商及服务商等企业提供市场推广平台。并且，展区还将设立高端人才交流展区。有意向预定展位的厂商请联系 janey@fsemi.tech 与有关人员洽询。

会议财务（含收入和支出）事宜均由北京恒仁致信咨询有限公司负责。

四、大会秘书组、会务组联系方式

西安交通大学	魏晓清：电话：18392959178	Email: icept@fsemi.tech
中科院微电子研究所	尹雯：电话：010-82995675	
会议注册联系人	王晓楠：电话：13121110782	Email: support@fsemi.tech
会议赞助联系人	施玥如：电话：13661508648	Email: janey@fsemi.tech
	周娟娟：电话：13683163150	Email: juanjuan.zhou@fsemi.tech
	乔虹毓：电话：13772049433	Email: qiaohy@sastc.com.cn

